



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年8月12日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社アバールデータ

コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 広光 勲

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部部長

(氏名) 大関 拓夫

TEL 042-732-1000

四半期報告書提出予定日 平成27年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	1,756	19.4	176	769.7	193	401.9	122	339.3
27年3月期第1四半期	1,470	14.5	20	371.7	38	12.7	27	15.4

(注)包括利益 28年3月期第1四半期 109百万円 (438.1%) 27年3月期第1四半期 20百万円 (46.4%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第1四半期	18.83	18.72
27年3月期第1四半期	4.46	4.40

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第1四半期	10,982	9,176	77.2
27年3月期	11,102	9,130	76.0

(参考)自己資本 28年3月期第1四半期 8,476百万円 27年3月期 8,434百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	5.00	—	10.00	15.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	8.00	—	11.00	19.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	3,350	16.1	245	145.4	265	116.4	170	117.4	26.12
通期	6,700	5.5	520	20.1	550	17.2	355	16.0	54.53

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	28年3月期1Q	8,064,542 株	27年3月期	8,064,542 株
② 期末自己株式数	28年3月期1Q	1,551,376 株	27年3月期	1,562,176 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期1Q	6,509,647 株	27年3月期1Q	6,250,481 株

(注)当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しております。当該プランにかかる従持信託が所有する当社株式数については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該従持信託が所有する当社株式数については、「期末自己株式数」に、28年3月期1Qは76,300株、27年3月期は83,100株をそれぞれ含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から28年3月期1Qは78,500株、27年3月期1Qは120,585株を控除しております。

なお、信託型従業員持株インセンティブ・プランの詳細については【添付資料】4ページ(3)「追加情報」に記載しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

なお、四半期決算補足説明資料は、平成27年8月12日(水曜日)に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(3) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
4. 補足情報	10
(1) 生産、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、継続的な政府による経済・金融政策などを背景に、企業収益や設備投資に改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調が続いております。しかしながら円安による物価上昇に伴う個人消費の弱さや海外景気の下振れなどの懸念要因もあり、先行きは不透明な中で推移いたしました。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、大手半導体メーカーの次世代プロセス関連の設備投資により、半導体製造装置関連市場における需要は回復基調で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループは顧客満足度の更なる向上のために、市場ニーズを先取りした新製品の投入によりお客様の装置の競争力向上に貢献するとともに、品質面では業界水準を超える品質の確保、更に社内の業務プロセスを見直すことにより、収益性の向上に取り組みました。

この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は1,756百万円（前年同四半期比19.4%増）、自社製品全般の売上高の増加に加え、効率的な研究開発活動を行った結果、前年同四半期と比べ研究開発費が減少したことにより営業利益は176百万円（前年同四半期比769.7%増）、経常利益は193百万円（前年同四半期比401.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は122百万円（前年同四半期比339.3%増）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第1四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器および計測機器の開発・製造・販売を行っております。半導体製造装置関連市場におきましては、大手半導体メーカーの設備投資により、概ね順調に推移いたしました。また、計測機器におきましては、各種計測機器の受注が増加傾向で推移しております。

この結果、売上高は1,145百万円（前年同四半期比14.4%増）、セグメント営業利益は165百万円（前年同四半期比89.1%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。大手半導体メーカーのLSI微細化が続く中、最先端の半導体製造装置への設備投資により、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は769百万円（前年同四半期比25.2%増）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、社会インフラ関連の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。社会インフラ関連の売上高は増加いたしました。産業用装置の立ち上がりの遅れにより、売上高は減少いたしました。

この結果、売上高は136百万円（前年同四半期比6.8%減）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。各種計測機器の受注は回復傾向にありますが、売上高はわずかに減少いたしました。

この結果、売上高は240百万円（前年同四半期比0.3%減）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュールおよび計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器およびソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。一般的な産業用装置における設備投資は回復基調にあり、自社製品全般で順調に推移しました。

この結果、売上高は610百万円（前年同四半期比30.3%増）、セグメント営業利益は136百万円（前年同四半期比131.0%増）となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般および医療機器関連における新規受注が貢献し、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は129百万円（前年同四半期比44.1%増）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。FA全般および液晶関連装置はいまだ本格的な回復には至っておりませんが、新製品の立ち上がりに加え食品、医薬品などの新分野における検査装置の営業開拓が順調に進み、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は188百万円（前年同四半期比25.2%増）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI（Computer Telephony Integration）・リモート監視機器およびスマート電源装置を提供しております。超高速シリアル通信モジュールは検査装置向けが停滞しましたが、CTI関連が順調に推移したため、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は226百万円（前年同四半期比16.9%増）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェアおよび付属の周辺機器を提供しております。自社製品全般の回復により、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は66百万円（前年同四半期比91.4%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産は10,982百万円（前連結会計年度末比119百万円の減少）となりました。

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が28百万円減少、受取手形及び売掛金が48百万円減少、たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）が35百万円増加、その他が主に繰延税金資産の減少、未収入金の増加等により32百万円減少しております。この結果、72百万円減少し7,418百万円となりました。

固定資産につきましては、主に、有形固定資産及び無形固定資産がそれぞれ7百万円減少し、また、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動の影響等により31百万円減少しております。この結果、46百万円減少し3,564百万円となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は1,805百万円（前連結会計年度末比165百万円の減少）となりました。

流動負債につきましては、主に、支払手形及び買掛金が103百万円減少、未払法人税等が11百万円減少、賞与引当金が144百万円減少、役員賞与引当金が7百万円減少、その他が預り金、前受金等の増加並びに未払消費税等の減少等により115百万円増加しております。この結果、151百万円減少し1,398百万円となりました。

固定負債につきましては、主に、退職給付に係る負債が4百万円減少、その他が繰延税金負債の減少等により9百万円減少しております。この結果、13百万円減少し407百万円となりました。

なお、負債項目に記載しております、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は9,176百万円（前連結会計年度末比46百万円の増加）となりました。

主に、利益剰余金が56百万円増加、自己株式が7百万円減少、その他有価証券評価差額金が21百万円減少、非支配株主持分が4百万円増加したことが要因となります。なお、自己株式の減少は、ストックオプション行使によるものが2百万円、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」によるものが4百万円となります。

(自己資本比率)

当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は77.2%（前連結会計年度末比1.2ポイントの増加）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の予想につきましては、当社グループに関連の深い半導体製造装置業界の市況環境や需要環境の回復が遅れており予断を許しませんが、概ね計画通りに推移しており、現時点では、平成27年5月13日付「平成27年3月期 決算短信」に公表いたしました数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はございません。
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

- (3) 追加情報

(信託型従業員持株インセンティブ・プランの会計処理について)

本プランでは、当社が信託銀行に「アパールグループ社員持株会専用信託口」（以下「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、本プランを導入後6年間にわたり「アパールグループ社員持株会」（以下「本持株会」といいます。）が取得すると見込まれる規模の当社株式312,400株を予め取得いたします。その後、従持信託から本持株会に対して毎月当社の株式を売却いたします。なお、従持信託は当社株式を取得するための資金確保のため、当社保証の銀行借入を行っております。

信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額等が累積した場合には、当該株式売却益相当額等が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積した場合には、当該株式売却損相当の借入金残高について、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約書に基づき、当社が弁済することとなります。

従持信託が所有する当社株式を含む資産及び負債ならびに費用及び収益については、当社と従持信託は一体であるとし、当社の四半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて処理しております。これに伴い従持信託が実行した借入金残高 79,130千円（前連結会計年度末 79,130千円）を四半期連結貸借対照表に計上しております。また、従持信託が所有する株式については純資産の部に自己株式として表示しており、当四半期連結会計期間末（平成27年6月30日）における自己株式の帳簿価額及び株式数は、以下のとおりであります。

純資産の部の自己株式の帳簿価額 1,041,021千円、自己株式数 1,551,376株（前連結会計年度末 1,048,076千円、1,562,176株）。

うち、当社所有の自己株式の帳簿価額 992,036千円、自己株式数 1,475,076株（前連結会計年度末 994,726千円、1,479,076株）。

うち、従持信託所有の自己株式の帳簿価額 48,984千円、自己株式数 76,300株（前連結会計年度末 53,350千円、83,100株）。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,971,686	3,942,821
受取手形及び売掛金	1,360,816	1,311,909
電子記録債権	337,623	338,799
有価証券	10,173	10,174
商品及び製品	376,091	359,833
仕掛品	303,004	283,771
原材料及び貯蔵品	901,406	972,583
その他	230,846	198,806
流動資産合計	7,491,648	7,418,700
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	798,417	791,044
有形固定資産合計	2,115,117	2,107,744
無形固定資産		
	89,748	82,325
投資その他の資産		
投資有価証券	1,342,931	1,311,819
その他	92,402	91,879
貸倒引当金	△29,676	△29,646
投資その他の資産合計	1,405,657	1,374,052
固定資産合計	3,610,522	3,564,122
資産合計	11,102,170	10,982,823

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	949,029	845,105
1年内返済予定の長期借入金	27,000	27,000
未払法人税等	28,294	16,659
賞与引当金	266,343	121,438
役員賞与引当金	11,837	4,743
その他	267,333	383,063
流動負債合計	1,549,837	1,398,009
固定負債		
長期借入金	52,130	52,130
役員退職慰労引当金	67,502	67,502
退職給付に係る負債	71,774	67,477
その他	230,221	220,759
固定負債合計	421,628	407,868
負債合計	1,971,465	1,805,878
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,444,942	2,444,942
利益剰余金	4,174,125	4,230,326
自己株式	△1,048,076	△1,041,021
株主資本合計	7,925,085	7,988,343
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	509,090	488,032
その他の包括利益累計額合計	509,090	488,032
新株予約権	10,716	10,340
非支配株主持分	685,813	690,229
純資産合計	9,130,705	9,176,944
負債純資産合計	11,102,170	10,982,823

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
売上高	1,470,527	1,756,510
売上原価	1,013,973	1,164,347
売上総利益	456,553	592,162
販売費及び一般管理費	436,292	415,957
営業利益	20,260	176,205
営業外収益		
受取利息	147	230
受取配当金	15,304	15,382
その他	3,134	2,285
営業外収益合計	18,586	17,897
営業外費用		
支払利息	162	110
支払手数料	41	41
営業外費用合計	203	151
経常利益	38,643	193,951
特別損失		
固定資産売却損	—	161
固定資産除却損	0	12
特別損失合計	0	174
税金等調整前四半期純利益	38,643	193,777
法人税、住民税及び事業税	1,356	14,616
法人税等調整額	13,299	48,419
法人税等合計	14,655	63,036
四半期純利益	23,987	130,740
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△3,911	8,166
親会社株主に帰属する四半期純利益	27,899	122,574

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
四半期純利益	23,987	130,740
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	△3,602	△21,058
その他の包括利益合計	△3,602	△21,058
四半期包括利益	20,385	109,682
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	24,296	101,516
非支配株主に係る四半期包括利益	△3,911	8,166

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,001,551	468,975	1,470,527
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	1,001,551	468,975	1,470,527
セグメント利益	87,779	59,276	147,055

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	147,055
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△126,794
四半期連結損益計算書の営業利益	20,260

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年6月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	1,145,545	610,964	1,756,510
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	1,145,545	610,964	1,756,510
セグメント利益	165,999	136,901	302,900

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利 益	金 額
報告セグメント計	302,900
セグメント間取引消去	—
全社費用(注)	△126,694
四半期連結損益計算書の営業利益	176,205

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	482,784	40.3	521,868	8.1
産業用制御機器	103,410	9.0	97,737	△5.5
計測機器	203,405	25.6	188,056	△7.5
小計	789,600	31.4	807,662	2.3
自社製品				
組込みモジュール	51,975	△24.6	78,850	51.7
画像処理モジュール	76,949	59.1	102,365	33.0
計測通信機器	86,408	5.6	101,787	17.8
小計	215,333	8.1	283,002	31.4
合計	1,004,933	25.6	1,090,665	8.5

(注) 1 金額は製造原価にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	18,284	△61.5	57,424	214.1
合計	18,284	△61.5	57,424	214.1

(注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	548,580	△2.0	561,532	2.4
産業用制御機器	119,950	△25.7	194,231	61.9
計測機器	222,167	9.3	270,837	21.9
小計	890,698	△3.7	1,026,602	15.3
合計	890,698	△3.7	1,026,602	15.3

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	189,795	△26.2	251,021	32.3
産業用制御機器	134,078	△15.7	265,144	97.8
計測機器	187,481	16.7	298,528	59.2
小計	511,355	△11.4	814,693	59.3
合計	511,355	△11.4	814,693	59.3

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	614,484	23.4	769,053	25.2
産業用制御機器	146,077	17.6	136,137	△6.8
計測機器	240,990	29.9	240,355	△0.3
小計	1,001,551	24.0	1,145,545	14.4
自社製品				
組込みモジュール	89,978	△20.0	129,621	44.1
画像処理モジュール	150,482	23.7	188,453	25.2
計測通信機器	193,846	2.6	226,534	16.9
自社製品関連商品	34,668	△35.3	66,354	91.4
小計	468,975	△1.6	610,964	30.3
合計	1,470,527	14.5	1,756,510	19.4

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 受注高及び受注残高は受託製品セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。